

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-007

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称/人员姓名	中珏私募基金、华鑫证券、诺安基金、优赛创投、殷勤集团、和讯信息科技有限公司、泽川投资、创华投资、善思投资、小鱼资本、上海小佳科技等机构及个人投资者
时间	2026 年 8 月 19 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍基本情况和发展历程。 二、公司与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： Q1、公司液冷业务目前的整体进展和收入情况如何？ 答：公司液冷散热业务源于在半导体封装材料领域的技术积累，凭借在精密金属加工领域的工艺能力，在行业需求兴起之初，公司就与台湾核心客户持续进行共同开发、持续打样等小批量生产，当前业务处于从验证导入向规模化交付过渡的关键阶段。公司主要为客户提供 GPU 液冷模组及机柜内部歧管等核心部件，目前该产品线将跟随客户量产节奏推进，整体放量节奏与客户的交付排期高度关联。当前订单能见度较前期有所提升。 公司实际收入规模受客户最终订单量、产品价格、量产节奏等多重因素影响，如有达到披露标准的相关事项，公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 Q2、公司液冷业务的产品形态和交付模式是怎样的？

	答：公司液冷产品以液冷板、液冷模组为主，同时包括歧管、波纹管及相关零配件。在交付模式上，公司并非简单的代加工，而是深度参与客户的产品研发。公司与客户双方进行共同联合研发与工艺验证，公司根据客户最终确认的设计进行生产交付。公司是客户冷板、管路、歧管、模组等核心部件供应商。 Q3、公司目前的产能情况以及未来的扩产计划是怎样的？ 答：公司液冷散热业务生产基地位于广东惠州，目前完成了第一期的产能建设。为应对市场需求增长和客户的产能规划指引，公司已启动了第二期扩产计划，包括厂房装修、电力扩容以及关键设备的预定等。一期与二期产能全部建成后，将能有效满足核心客户的阶段性交付需求。后续公司将根据市场情况和客户订单的进一步明确，审慎规划后续产能扩张，整体产能建设与客户放量节奏保持匹配。 Q4、公司如何看待与下游客户的合作关系？技术的护城河体现在哪里？ 答：公司与台湾客户的合作，是建立在长期信任和共同研究开发基础上的深度业务合作关系，并非简单的代工。公司能直接参与到客户产品的早期设计和验证环节，从项目启动至今已持续迭代多个版本，构成了双方合作的重要基础。 公司的核心竞争力主要体现在三个方面： 第一，工艺技术方面，公司在精密焊接、钎焊等关键工艺上拥有深厚积累和独到技术，形成了从材料到结构件再到模组组件的全链条能力。 第二，客户关系与先发优势方面，公司作为早期就进入该供应链体系的核心供应商，与客户共同经历了多代产品的迭代，双方在技术理解、工艺储备与迭代节奏上保持同步，这种合作关系和行业积累难以在短期内被复制。 第三，全链条制造与品控能力方面，公司具备从机加工、焊接、组装到清洗检测的全流程制造能力，尤其在后端清洗、检测等环节投入较多资源，在保证产品一致性和可靠性方面建立了较高的壁垒，可面向
--	---

	终端客户提供整套系统级解决方案。 Q5、公司在国内液冷市场的拓展情况如何？ 答：在国内，公司已积极与头部算力基础设施厂商、服务器及互联网企业进行接洽和送样。目前公司已向国内多家头部算力基础设施厂商送样，随着国产ASIC芯片算力持续提升，国内市场液冷散热需求同样强劲，公司将依托在海外市场积累的技术能力和产品经验，探索液冷散热解决方案在国产ASIC生态中的应用，逐步拓展国内市场份额。 Q6、公司如何看待液冷业务的毛利率水平及未来趋势？ 答：由于公司液冷业务目前仍处于从打样、小批量向规模化交付过渡的早期阶段，当前的毛利率水平尚不能完全反映规模化后的盈利能力。未来随着订单量的持续释放和产能利用率的提升，毛利率有望逐步稳定。 公司保持审慎态度，从中长期来看，随着液冷行业逐步成熟、市场参与者的增加以及规模上量，产品价格可能面临一定的下行压力。同时，公司也在积极布局下一代液冷技术产品，持续与客户进行联合研发和验证，伴随着芯片功耗不断提升，新产品技术壁垒更高、价值量更大，有望在价格下行周期中为公司提供结构性支撑，形成产品的迭代梯队，维持液冷业务整体的盈利水平。公司看好液冷业务的长期发展前景，具体收入和利润贡献将结合终端需求、供应份额、产品结构、量产进度及成本控制等多重因素体现。 Q7、公司半导体封装材料业务和智能卡业务的现状如何？ 答：半导体封装材料业务方面，公司产品主要应用于功率半导体领域，客户为国内知名封装企业。该业务近年来保持高速增长态势，其主要原材料铜的价格波动通过与客户的联动定价机制进行传导，以锁定合理的加工利润。公司后续将根据市场需求及经营情况审慎扩大产能。智能卡业务方面，该业务已进入成熟期，公司计划继续维持现有规模，保持稳定现金流，目前在智能卡业务方面不会进行重大资本性投入，预计将继续维持现有水平。
风险提示	公司提醒投资者注意：新业务新产品开发过程中存在一定的技术风

	险、市场风险和应用验证周期风险，实际收入及盈利水平受客户订单、产品价格、量产节奏等多重因素影响，存在不确定性；随着行业参与者的增加可能将加剧市场竞争；原材料价格波动亦可能对盈利能力产生影响。上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2026-8-19